## 上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-20

	■特定对象调研	□分析师会议
投资者关系活动	□媒体采访	□业绩说明会
类别	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	□其他
参与单位名称及	财通证券、光大保德信基金	
人员姓名		
时间	2024年9月5日 10:00-11:	00
地点	上海市浦东新区申江路 5005 弄 3 号楼 10 层	
上市公司接待人	董事会秘书: 张漪萌	
员姓名		
投资者关系活动	一、2024年半年度业绩情况介绍	
主要内容介绍	2024年上半年,公司实	现营业收入 7.35 亿元, 同比
	增长 19.40%; 实现归属于	上市公司股东的净利润-
	3,050.76万元,同比减亏65	5.82%; 实现归属于上市公司
	股东的扣除非经常性损益的	争利润-1,783.53万元,同比
	减亏 87.25%。剔除各期股权	激励带来的股份支付费用影
	响,报告期内实现归属于上ī	市公司股东的净利润-593.50
	万元,同比减亏 78.39%;实	现归属于上市公司股东的扣
	除非经常性损益的净利润	国 673.74 万元, 同比增长
	108.63%。2024年上半年,公	司实现综合毛利率 35.43%,
	同比提升10.76个百分点。	
	公司第二季度实现营业。	收入 4.16 亿元, 较上年同期
	增长 18.79%; 实现归属于上	市公司股东的净利润-110.74
	万元,同比减亏 96.21%;实	现归属于上市公司股东的扣
	除非经常性损益的净利润	1,256.15万元,同比增长
	   120.12%。剔除股权激励产生	的股份支付费用影响,公司

第二季度实现归属于上市公司股东的净利润 1,028.59 万元,同比增加 20.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,395.48 万元,同比增长 197.16%;实现综合毛利率 36.75%,环比提升 3.04 个百分点,同比提升 10.96 个百分点。

## 二、问答环节

1、LED 照明业务收入下降的原因是什么? 有什么新的产品进展吗?

答:主要是因为报告期内 LED 照明产品价格下降幅度大于产品销量的增长幅度。但由于产品结构持续调整优化,智能照明产品收入持续增长,以及新一代工艺全面应用,使得产品成本降幅较为可观,报告期内 LED 照明产品毛利率得以持续修复。

新产品进展方面,公司在报告期内推出了适用于新照明国家标准的线性恒流 IC 芯片、应用于欧洲市场的可控硅调光线性恒流 IC 以及 DALI 调光驱动芯片等产品。

2、公司 DC/DC 电源芯片上半年进展如何?

答: 今年上半年,公司 DC/DC 电源芯片实现销售收入 669.36 万元,同比增长 1251.02%。公司 DC/DC 电源芯片产品已进入市场推广阶段,目前已获得两家国外知名主芯片厂商以及国内多家主芯片厂商认证,在 AIC、PC、服务器等领域实现量产。同时,公司自研低压工艺成熟度提升,已助力多款 DrMOS 产品批量出货;推出高功率密度电源模块产品并同步量产;可适配国内外多家 GPU 客户产品的 16 相多相控制器量产。

3、AC/DC 电源芯片增势明显的原因是什么?

答:主要原因是报告期内 AC/DC 电源芯片产品在各细分市场相继取得了业务突破,当前正处于快速上量阶段:大家电业务在国内多家白电品牌厂家取得破局,在

视源、麦格米特等标的板卡厂家中份额进一步提升;小家电业务在美的生活电器中取得破局,在国外著名品牌厂商的业务份额持续提升;应用于手机快充的外置 AC/DC 电源芯片,在两家国内品牌手机厂多个功率段产品中达成量产,持续投入研发的磁耦通讯产品也在市场上快速放量,以此为核心技术的零待机功耗 25W 和 35W 两款功率段产品已通过海外某品牌手机厂的评估测试。

另外,AC/DC研发进展可观,大家电电源芯片推出更多兼容国外友商的产品并已进入量产环节,同时产品耐压性及封装技术同步升级;在小家电领域,公司推出适用于离线语音应用的大电流供电芯片产品并实现量产;快充业务中磁耦通讯在架构上的高性价优势进一步显现,母线高压直接驱动氮化镓功率器件的产品实现批量生产。

## 4、电机控制驱动芯片产品线是否有重大进展?

答:公司电机控制驱动芯片业务已经与美的等多个大家电品牌客户建立业务合作并实现量产,报告期内在汽车空调出风口、车载空调压缩机及热管理系统等汽车电子业务领域进入量产阶段,与国内电动出行业务领域头部板卡厂达成战略合作,整体市场份额迅速提升,上半年营业收入同比增幅达到218.77%。

## 5、公司工艺进展如何?

答: 高压 BCD-700V 平台第六代工艺的研发在上半年已经初步完成; 低压 BCD 工艺 0.18 μ mBCD 工艺平台良率及可靠性指标已达到量产水平,可支持 DC/DC 电源芯片、低压电机驱动芯片等产品线。

附件清单(如	
有)	
日期	2024年9月5日